

2005 年 11 月 9 日

液晶ポリマー関連米国ベンチャーへ出資

住友化学は、液晶ポリマー（以下 L C P）による中空パッケージ事業（以下「L C P 中空パッケージ」）のベンチャー企業であるクウォンタム・リープ・パッケージング社 (Quantum Leap Packaging Inc.、本社：米国マサチューセッツ州、以下 QLP 社) が新規に発行する株式を購入し、同社へ出資することといたしました。出資額は 20 百万米ドルで、同社発行済み株式の 20.7%の株式を保有することになります。また、QLP 社が開発した「L C P 中空パッケージ」の日本及び韓国での非独占的販売権を得て、市場でのマーケティング活動を通じて事業の将来性を見極めた上、本事業への本格的な参入を図りたいと考えています。

L C P は、耐熱性、精密成型性に優れた樹脂で、主にコネクタなどの電子部品に使用されています。当社は、L C P 事業を情報電子化学部門の戦略事業として位置付け、国際競争力のある製造技術と優れた製品性能により、世界各地域において積極的に事業拡大を推進しています。また、従来から L C P の特性をいかした新規アプリケーションの開発、川下への展開について独自の技術で開発を進めてきました。

一方 QLP 社は、次世代技術として注目される「L C P 中空パッケージ」の研究・開発を進めてきましたが、従来の L C P の性能を大幅に上回る高機能 L C P（商標名：Quantech）の開発に成功すると共に、必要な成型加工技術・品質評価技術を開発し、「L C P 中空パッケージ」として、欧米を中心とする大手電子部品メーカー向けに事業化を進めています。近く先行する顧客での評価を完了し、商業ベースの供給を開始する予定です。

中空パッケージは、デジタルカメラ・携帯電話・コピー機等の中核部品となる半導体（C D イメージセンサー等）を外部環境から保護するために用いられます。これらの用途には、現在はセラミック製が主に使用されていますが、電子製品のダウンサイジングに伴い、微細かつ薄肉で複雑な形状が求められています。「L C P 中空パッケージ」は、その優れた成型性及び加工性により、薄肉化、軽量化、形状・設計の自由度の向上、さらに微細化配線を実現できることから、将来的にはセラミック代替の主役になる可能性があるかと期待されています。

当社は今回、QLP 社の優れた技術・開発力を活用することで研究期間を短縮し、「L C P 中空パッケージ」の早期事業化を進め、L C P 事業の拡大を図っていきたいと考えています。

以上